

## 腔体 Chamber

### 应用场景

- 半导体工艺如真空环境工艺和薄膜生长与掺杂等设备上的 TM/LL/PM（传送腔 / 过渡腔 / 反应腔）

### 特点和指标

- 具备铝合金和不锈钢腔体的生产能力，密封面粗糙度行业领先
- 表面处理具有硬质阳极 / 普通阳极 / APS / 刷镍 / 化洗的生产能力
- 刻蚀反应腔体高温阳极密封能力



## Chamber

关键参数	Vital
密封面粗糙度	Ra < 0.2μm
膜厚均一性	± 5%
BDV	> 600 V/mil
漏率	< 1E - 11 torr. L/min
遮蔽工艺界限	≤ ± 0.2mm
高温氮检能力	具有
腔体涂层	阳极 / APS / 刷镍
腔体类型	PM / TM / LL

技术能力		
技术模块	能力	参数
加工/制造	最大覆盖尺寸	3.6m
	精度	< 0.01mm
	焊接	TIG / EBW
材料	腔体材质	铝合金/不锈钢
	氮漏	< 1E - 9Mbar L/S